

中国国际金融股份有限公司
关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）为龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”、“龙迅股份”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对龙迅股份本次部分募集资金投资项目延期的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意龙迅半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕6 号）核准，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股股票 1,731.4716 万股，每股发行价格为人民币 64.76 元。截至 2023 年 2 月 14 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,731.4716 万股，募集资金总额为人民币 1,121,301,008.16 元，扣除各项发行费用合计人民币 91,020,020.91 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,030,280,987.25 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 2 月 14 日出具了容诚验字〔2023〕230Z0030 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	截至 2025 年 12 月 31 日募集资金累计投入金额	截至 2025 年 12 月 31 日募集资金累计投入比例 (%)
1	高清视频桥接及处理芯片开发和产业化项目	28,167.06	25,745.06	19,774.39	76.81
2	高速信号传输芯片开发和产业化项目	17,664.32	16,502.32	5,174.17	31.35
3	研发中心升级项目	34,667.69	33,547.69	4,326.95	12.90
4	发展与科技储备资金	20,000.00	20,000.00	-	-
合计		100,499.07	95,795.07	29,275.51	30.56

注：1、公司于 2025 年 2 月 27 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“高清视频桥接及处理芯片开发和产业化项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月，同意公司对募集资金投资项目“高速信号传输芯片开发和产业化项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-015）。

2、截至 2025 年 12 月 31 日，“高清视频桥接及处理芯片开发和产业化项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及第四届董事会第九次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“高清视频桥接及处理芯片开发和产业化项目”结项。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）。

3、上表中“截至 2025 年 12 月 31 日募集资金累计投入金额”未经审计。

三、本次募投项目延期情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际进展情况，在募集资金的投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对“研发中心升级项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
研发中心升级项目	2026 年 3 月	2027 年 3 月

（二）本次募投项目延期原因

自募集资金到位以来，公司根据战略规划和业务发展情况，有序推进募投项

目实施，审慎规划募集资金的使用。当前半导体行业技术迭代迅速、市场需求变化节奏快，公司为贴合前沿技术趋势，持续动态优化项目技术方案，相关论证与完善工作客观上延长了项目实施周期。同时，先进制程的评估与选择作为项目关键核心工作，公司不仅需从技术层面开展产品性能仿真、工艺适配性验证及 IP 核兼容性调试，还需结合成本结构、量产良率及供应链稳定性进行综合研判，以实现技术可行性与商业经济性的最优匹配，相关系统性论证工作周期较长。叠加公司秉持审慎原则，对核心研发设备及 IP 选型执行严苛标准，围绕技术先进性、兼容性、可靠性开展多轮反复论证，进一步拉长了采购与验证周期。此外，受行业高端研发人才供需紧张影响，项目核心技术团队组建及磨合进度不及预期，部分关键研发环节推进缓慢。综上多重因素，导致项目投资进度有所减缓，建设周期相应延长。

四、本次延期募投项目的必要性和可行性

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，公司对“研发中心升级项目”的必要性和可行性等进行了重新论证，本次延期仅对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体等，项目继续实施仍然具备必要性和可行性，具体论证如下：

（一）项目必要性分析

结合半导体设计行业发展趋势、公司业务发展需求及行业竞争格局，本次募投项目的实施具有明确必要性，具体如下：

1、当前半导体设计行业向高速化、集成化、场景化方向快速发展，高带宽 SerDes、车载超高清视频传输、8K 超高清视频处理、企业级 USB、PCIe Hub/Switch 芯片等技术已成为行业发展主流方向。为进一步提升公司技术研发能级，紧跟行业前沿技术演进节奏，公司亟需通过本次研发中心升级项目，构建更完善、更先进、更具竞争力的研发体系，为下一代核心技术突破与产品迭代提供坚实支撑。

2、随着智能车载、超高清显示、人工智能等下游市场快速扩容，对高端芯片产品的性能、可靠性及场景适配能力提出更高要求。实施本次研发中心升级项目，有利于公司进一步优化研发布局、提升研发效率、强化技术创新能力，加快推出更高性能、更具市场竞争力的芯片产品，巩固并提升公司在细分领域的市场地位，把握行业快速发展带来的战略机遇。

3、研发平台是集成电路设计企业持续创新的核心基础，本次研发中心升级项目围绕下一代 SerDes 技术、车载超高清视频传输和显示芯片、8K 超高清视频处理及显示芯片、企业级 USB PCIe Hub/Switch 系列芯片开展重点研发，有利于公司进一步升级研发硬件条件、完善研发流程体系、提升整体研发效能，打造更加专业化、体系化、现代化的研发平台，为公司长期技术创新与高质量发展提供持续动力。

4、本次研发中心升级项目紧密围绕公司发展战略展开，是公司强化核心技术储备、拓展高端应用市场、提升综合竞争实力的重要举措。项目实施有利于公司进一步提升技术壁垒、丰富产品矩阵、增强抗风险能力，推动公司在高端芯片设计领域持续做优做强，实现更高质量、更可持续的发展。

（二）项目可行性分析

结合行业发展环境、公司自身优势及项目实施条件，本次募投项目具备充分可行性，具体如下：

1、近年来，国家持续倡导半导体作为支柱产业要自主创新与高质量发展，持续出台税收优惠、投融资、人才等多项政策支持产业发展。项目所在的超高清视频、车载电子、AI 运力等领域市场需求快速增长，为公司相关技术研发与产品落地提供了广阔的市场空间和良好的产业环境，项目实施具备坚实的行业基础与市场条件。

2、公司长期专注于项目涵盖的智能视频芯片和互连芯片领域研发与市场推广，已形成较为成熟的技术体系、丰富的研发经验和稳定的产品落地能力，在相关领域具备良好的技术基础与市场优势。截至 2025 年底，公司共拥有各类知识产权 509 项，其中发明专利 147 项、集成电路布图设计专有权 136 项、软件著作

权 160 项。本次募投项目研发方向与公司现有技术体系高度契合，有利于公司在现有优势基础上进一步提升、延伸、强化，项目实施具备充分的技术可行性。

3、公司已建立成熟的人才引进、培养与激励机制，拥有稳定且专业的研发团队与项目管理团队，具备较强的技术研发、项目实施与质量管控能力。截至 2025 年底，公司共拥有研发人员 192 人，占公司员工总数的 75%。2026 年公司将强化高端人才及团队打造力度，为研发中心升级项目的实施提供坚实的人员保障。依托成熟的研发管理体系，公司能够高效组织研发资源、有序推进项目实施、确保研发成果快速转化，为研发中心研究成果顺利落地提供可靠保障。

（三）募集资金投资项目重新论证结论

公司对“研发中心升级项目”重新进行了研究和评估，认为该项目符合公司战略规划，仍具备投资的可行性和必要性，公司将继续实施上述募投项目，并将项目达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 3 月。在继续实施期间，公司将 对募集资金使用进行合理安排，并加快推进项目建设进度。

五、本次募投项目延期对公司的影响及后续保障措施

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目建设进度的变化，未改变募投项目的投资用途、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

为保证募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，控制募集资金的使用风险，公司据此审慎决定调整募集资金投资项目期限。后续，公司将严格遵守相关法律法规的规定，结合行业技术进步与公司业务发展实际，对募集资金投资项目的建设进度合理统筹，加强监督，积极协调相关资源，保障募投项目顺利实施。

六、公司履行的审议程序

公司于 2026 年 3 月 27 日分别召开了第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对募集资金投资项目“研发中心升级项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 3 月。该事项无需提交公司股东会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

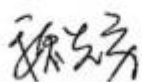
公司本次对部分募投项目延期已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。该事项是公司基于募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益，符合有关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定。

综上，保荐机构对本次部分募投项目延期的事项无异议。

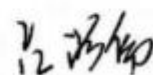
（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



魏先勇



占海伟

